



第十五届(2027)中国电子专用设备工业协会半导体设备年会

The 15th (2027) CEPEA Semiconductor Equipment Annual Conference

第15届国际半导体设备材料及核心部件博览会 (CSEAC CHINA 2027)

The 15th International Semiconductor Equipment, Materials and Core Parts Expo

²⁰₂₇ 09/01-09/03 中国·苏州

www.cseac.org.cn

CEPEA半导体设备年会

CEPEA半导体设备年会，全称为“**中国电子专用设备工业协会半导体设备年会**”，由中国电子专用设备工业协会牵头主办。其发展历程与中国半导体设备产业的崛起同频共振，从最初的行业交流平台，逐步成长为全球半导体设备领域具有重要影响力的年度盛会，为我国半导体装备、核心部件企业与半导体制造、封测企业提供了项目合作、市场推广的契机；为国产半导体设备产品和部件进入国内外产业链用户和全球采购体系提供了最直观、最全面的合作商机；每届年会都是客户和供应商对接洽商、新老朋友相聚交流的友好互动平台。

国际半导体设备材料及核心部件博览会（CSEAC CHINA）

国际半导体设备材料及核心部件博览会(CSEAC CHINA)由上海风米云传媒科技有限公司主办，是我国半导体设备与核心部件领域最具权威展会，众多专家、学者和展商、观众共同铸就了CSEAC的专业性、品牌影响力与资源召唤力。CSEAC以“**专业化、产业化、国际化**”为宗旨，深耕半导体全产业链生态建设多年，是集**技术交流、成果展示、新品发布、经贸对接、国际合作**于一体的核心产业平台，持续助力半导体产业国产化、高端化、国际化的升级发展。

关于CSEAC CHINA 2027

第15届国际半导体设备材料及核心部件博览会(CSEAC CHINA 2027)将于2027年9月1日-9月3日在苏州国际博览中心举行。本届展会以“**芯合力·连全球 (Chips Together, Global Connection)**”为核心主题，依托苏州及长三角地区雄厚的半导体产业基础、完善的产业配套与优质的区位协同优势，展会全面升级办展规格与产业服务能力，承接往届展会积淀的优质产业资源，继续聚焦半导体设备、核心零部件、配套材料、精密制造、检测设备等关键赛道，立足国产替代、国际合作核心趋势，集聚上下游优质资源，打造更高规格、更高精度、更高实效的专业化展示与商贸对接平台。



历经多届深耕沉淀，CSEAC展会规模与行业影响力连年跨越式增长，自2022年起展会产业化、规模化进程全面提速，历届数据持续刷新行业纪录，稳步成长为中国半导体设备、材料、核心部件领域的标杆性行业盛会，完整呈现国产半导体装备产业崛起历程，
各届核心数据如下：



国际半导体年度大聚汇

展会展览面积超90000m²，设晶圆制造设备、封测设备、辅助设备/核心零部件、半导体材料、综合类五大展区，完整覆盖半导体全产业链。

1 权威论坛矩阵

同期配套多场高规格行业论坛，汇聚院士、技术专家、龙头企业代表，聚焦市场趋势与产业链痛点，研讨输出前沿解决方案。

2 国际资源汇聚

集聚数百家海外参展企业，设立海外专场专区；专业观众来自全球多国及地区，搭建国际化商贸交流桥梁。

3 新品集中亮相

举办新品专场发布与创新大赛，集中展示半导体设备及核心零部件前沿创新成果，搭建技术展示、成果交易、品牌推广综合平台，加速创新产品产业化落地。

4 精准供需对接

开设供需洽谈专场，对接研发端与应用端，实现上下游精准匹配，助力国内半导体产业高质量发展。

5 构筑人才生态

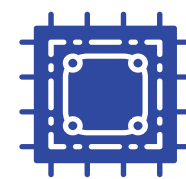
联动双一流高校推进产学研协同与科研成果转化；开设人才招聘专区，汇聚百家企业现场纳才，打通人才与企业双向对接通道，激活产业人才活力。

6 配套服务完善

展会落地苏州国际博览中心，地处苏州工业园区CBD核心位置，地铁直达，高铁快速通达长三角主要城市。会议、商务、餐饮、停车等一站式配套齐全，周边酒店、商业资源丰富，为参展、观展、商务洽谈提供便捷完备的办展保障。



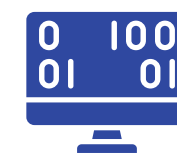
半导体产业关键设备与材料



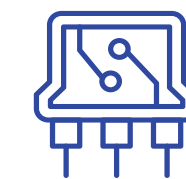
晶圆制造设备



核心部件及耗材



封测设备



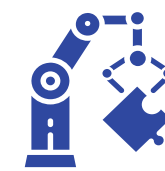
前道材料



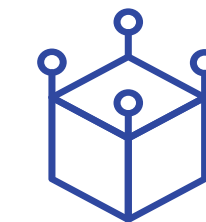
后道材料



照相制版设备



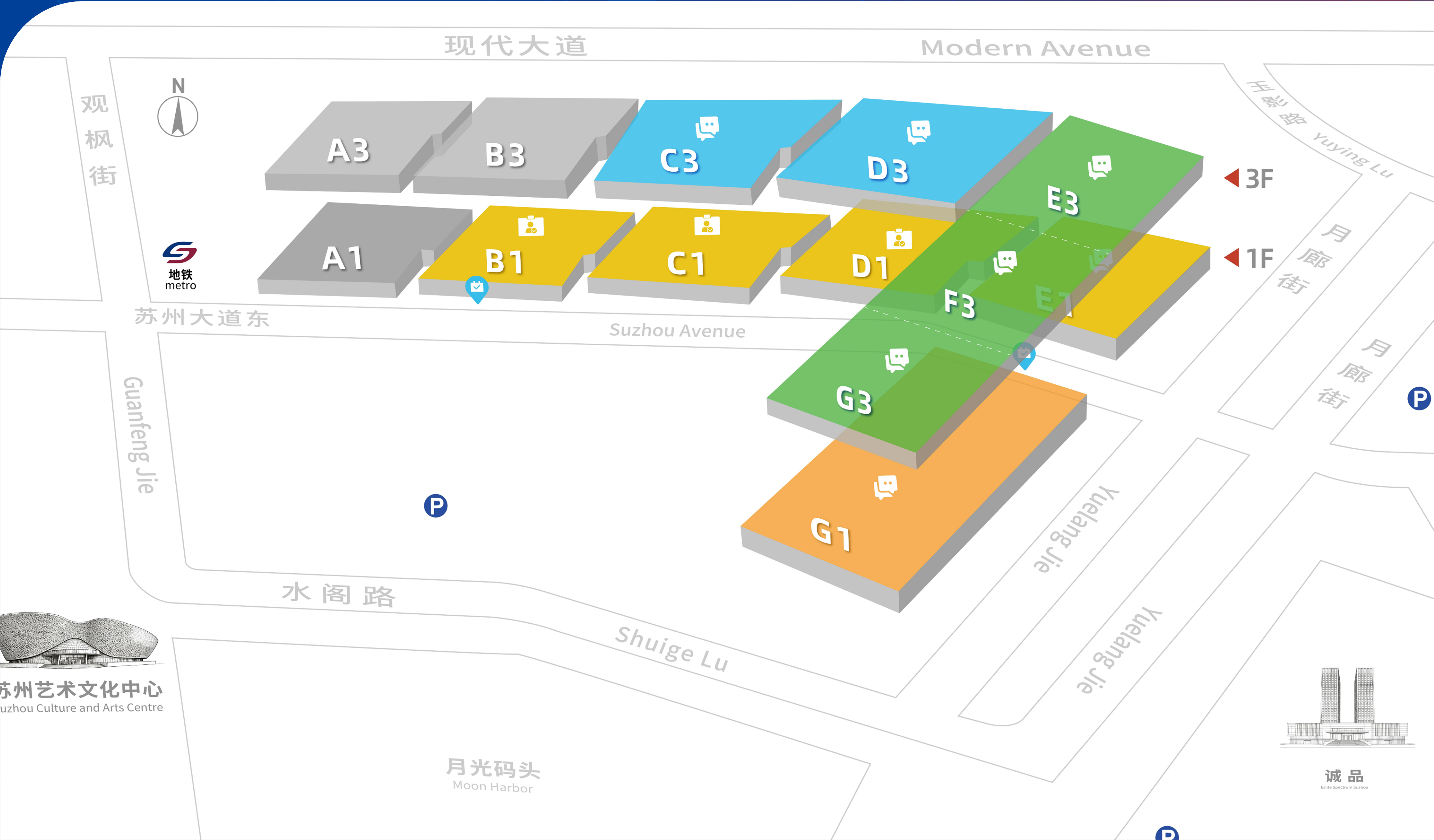
半导体显示



厂房设施 污染控制

CSEAC CHINA 2027 展馆分布图

芯合力·连全球
Chips Together Global Connection



- B1** 晶圆制造设备展区
Wafer Fabrication Equipment Exhibition Area
- C1** 封测设备展区/晶圆制造设备专区
Packaging and Testing Equipment Exhibition Area/
Wafer Fabrication Equipment Exhibition Area
- D1** 辅助设备/核心部件及材料展区
Auxiliary Equipment /
Core Parts and Materials Exhibition Area
- E1** 辅助设备/核心部件及材料展区
Auxiliary Equipment/
Core Parts and Materials Exhibition Area
- C3** 封测设备/晶圆制造设备/
辅助设备/核心部件及材料展区
Packaging and Testing Equipment /
Wafer Fabrication Equipment / Auxiliary Equipment /
Core Parts and Materials Exhibition Area
- D3** 晶圆制造设备/封测设备/
辅助设备展区
Wafer Fabrication Equipment Exhibition Area/
Packaging and Testing Equipment Exhibition Area/
Auxiliary Equipment Exhibition Area
- E3** 封测设备/晶圆制造设备/辅助设备/
核心部件及材料展区
Packaging and Testing Equipment /
Wafer Fabrication Equipment / Auxiliary Equipment /
Core Parts and Materials Exhibition Area
- F3** 封测设备/晶圆制造设备/辅助设备/
核心部件及材料展区
Packaging and Testing Equipment /
Wafer Fabrication Equipment / Auxiliary Equipment /
Core Parts and Materials Exhibition Area
- G3** 封测设备/晶圆制造设备/辅助设备/
核心部件及材料展区
Packaging and Testing Equipment /
Wafer Fabrication Equipment / Auxiliary Equipment /
Core Parts and Materials Exhibition Area
- 展商报到处
Exhibitor registration office
- 论坛区
Forum area
- 登记大厅
Registration hall



CSEAC CHINA 2027 展位预定

芯合力·连全球
Chips Together Global Connection

CSEAC CHINA 2027 自启动招展以来，持续获得行业龙头企业广泛认可与踊跃参与，首轮展位已全部售罄。为满足更多企业参展需求，组委会正积极推进展区扩容，释放更多优质展位资源。

国内半导体设备、零部件、材料赛道头部企业已率先完成展位锁定。重点头部企业包括北方华创、中微公司、盛美、拓荆科技、上海微电子、珂玛科技、电科装备、新凯来、江丰电子等悉数翻倍扩面进场，俄罗斯展团、西诺斯、亚德客等国际化阵容也已大展位确认亮相，多家产业链优质企业、行业领跑企业持续加码参展，提前抢占年度核心展示窗口，产业集聚效应持续凸显。



扫码进入线上展厅
查看实时展位预定进度

展位销售价格



光地：**3000元/平米**

18m²起订,自行设计搭建特装



标摊：**3.2万元/个**

3m*3m, 包括: 空白背墙、咨询桌、椅子、射灯、220V/5A电源插座、地毯, 需自行制作展板画面



CSEAC CHINA 2027 活动与配套服务

芯合力·连全球
Chips Together Global Connection



• 展前预热:

设备、核心部件创新大赛
展位邀请函，一键转发邀客户

• 现场直击:

新技术、新产品发布会
权威产业、市场数据发布

• 观众引流:

扫码打卡兑好礼
特定展位定时抽奖

• 快速定位:

展商名录、展位定点一键直达
实时获取最新论坛议程

• 媒体矩阵:

全媒体平台联动，全展期专业报道
直播探展、视频专访，
双渠道深度传播

• 复盘解读:

专业展会总结报告

• 长效服务:

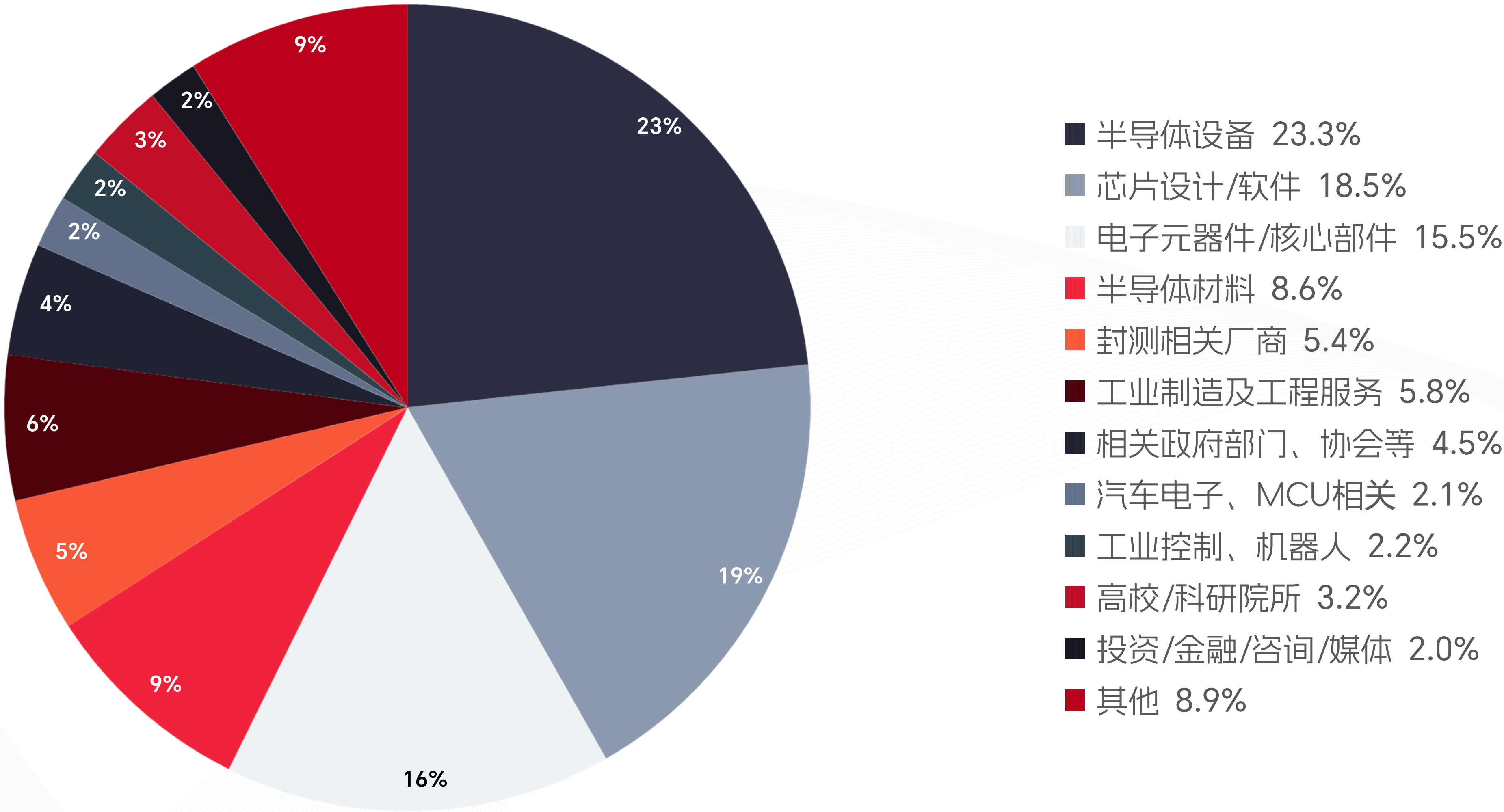
风米网-半导体供应链产品平台



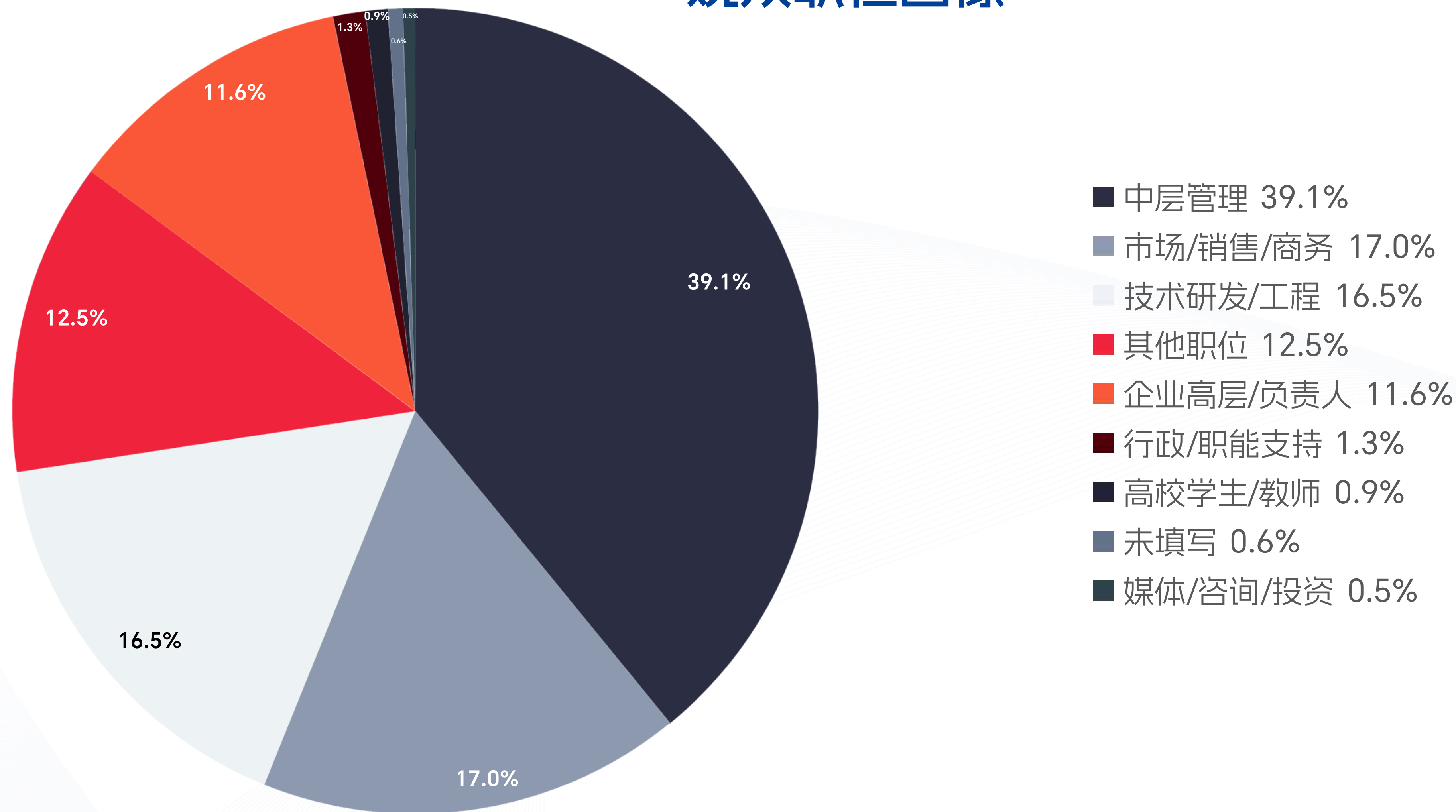
- 江苏省省长亲临CSEAC展会现场巡馆指导
- 国内外龙头企业齐聚，集结半导体全链力量
- 新品集中亮相，两大创新奖项重磅揭晓
- 20余场专业论坛，汇聚产业发展智慧
- 全球25个国家和地区参与，大咖云集，资源互通
- 供需对接，让洽谈走向务实合作
- 120+校企联动，贯通成果转化与人才对接



观众行业类别（全体报名）



观众职位画像





微电子世界(CEPEM, www.cepem.com.cn):成立于2013年的半导体行业资讯媒体,拥有20余万粉丝,每日提供微电子领域资讯、企业动态、行业报告等。公众号、视频号、抖音均开设同名帐号。

- 单篇行业内容阅读量破100W+
- 拥有300+行业社群超7万+用户



关注CEPEM

200万
全年自媒体平台阅读&播放总量

20万
全平台粉丝

合作媒体





风米网—半导体供应链产品平台

专业的半导体供应链产品平台。以产品为导向，按半导体工艺流程进行全项分类，
用户能够快速检索与查询产品信息，助力企业提质、降本、增效。
目前，平台已吸引了2000多家企业入驻与使用，网站内已完善数千个细分产品。

数千产品在线查询

逾千家企业入驻

供求双方高效对接

IC产业链全景呈现



专业

高效

快捷



风米网公众号



风米网小程序



风米网视频号

网址: www.fengm.cn
座机: 86-4000005586
邮箱: Sales@fengm.cn
地址: 上海市浦东新区东方路710号
汤臣金融大厦24层

随时随地，
打开风米网，开启无限商机

为规范招商流程、保障企业参展权益，
本届展会展位预定统一通过**组委会官方渠道对接**。

老展商续约：已对接组委会销售的合作企业，
可直接联系原专属对接人办理2027年展位选位与续约手续。



新企业参展咨询：

首次参展企业可联系

黄先生 (hg@cseac.org.cn)

甘女士 (faith@cseac.org.cn)

或扫码咨询参展详情。